

46-3931 / 46-3932 Economy Version

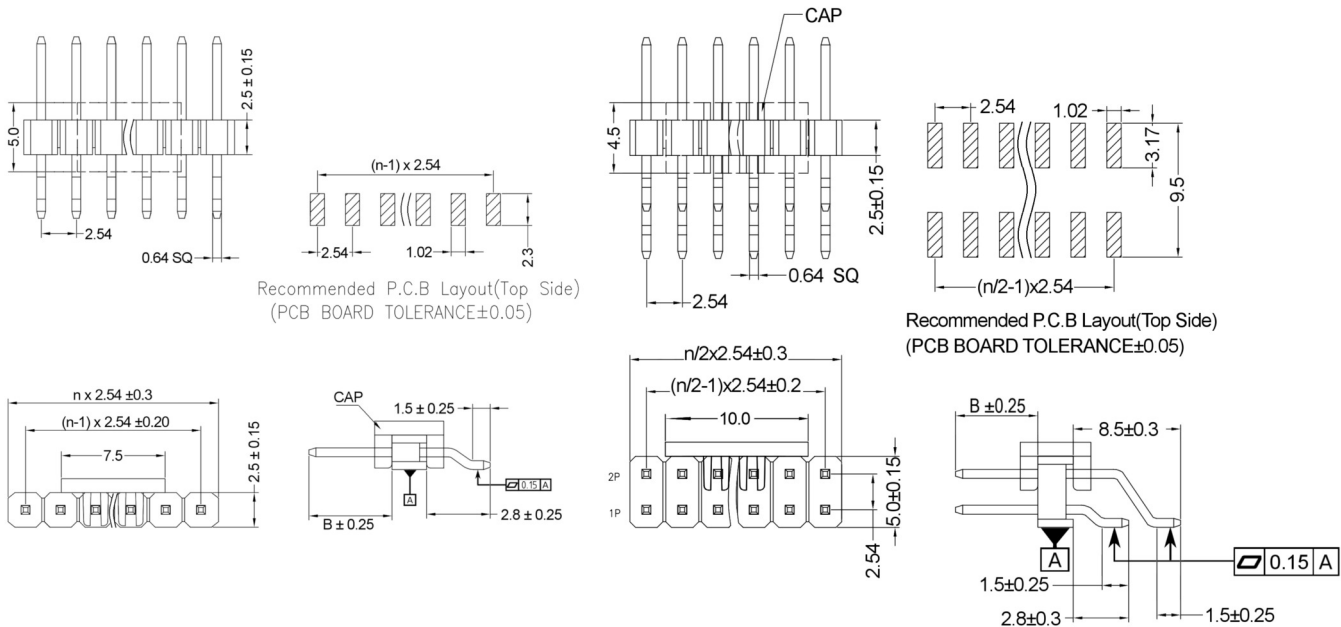
SMT-Stiftleisten RM 2,54mm, liegend, 1-/2-reihig
SMT Pin Headers, 2.54mm Pitch, Horizontal, Single/Double Row

Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplast, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Vierkantstift 0,64mm, Kupferlegierung <i>0.64mm square pin, copper alloy</i>
Kontaktoberfläche <i>Contact Surface</i>	Au über Ni <i>Au over Ni</i>
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	20 mΩ max. <i>20 mΩ max.</i>
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	1000 MΩ min. <i>1000 MΩ min.</i>
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	1000 V AC/DC <i>1000 V AC/DC</i>
Nennstrom <i>Current Rating</i>	3 A <i>3 A</i>
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-40 °C ... +105 °C <i>-40 °C ... +105 °C</i>
Verarbeitung	230 °C für 30-60 Sekunden (260 °C für 10 Sekunden) <i>230 °C for 30-60 seconds (260 °C for 10 seconds)</i>
Processing	



Passende Buchsenleisten:
Compatible Female Headers:
46-3490 46-3491 etc.
Weitere siehe Kapitel B
more



Series*

46-3931

46-3931 Einreihig
Single row
46-3932 Zweireihig
Double row

Dimensions*

11

95 B=4,00mm
11 B=5,30mm
12 B=5,80mm
13 B=7,10mm
14 B=8,40mm

Contacts*

008

002-020 Einreihig
Single row
004-060 Zweireihig
Double row

Plating

00

00 Vergoldet
Gold plated

Packaging*

PPST

ST
PPST
PPTR

* Dies ist ein Bestellbeispiel -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an order example -
please replace by your specifications.

Lieferformen / Packaging Options:

ST In Stangen ohne Pick&Place-Pads / *In tubes w/o Pick&Place-Pads*
PPST In Stangen mit P&P-Pads / *In tubes with P&P-Pads*
PPTR Tape & Reel mit P&P-Pads / *Tape & Reel with P&P-Pads*

Reflow-Lötverfahren

Reflow Soldering Information

Reflow-Lötempfehlung für kurze Lötzeiten

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum T_{Smin}	150 °C
Temperatur Maximum T_{Smax}	200 °C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Temperatur Lötbereich T_L	untere Temperaturangabe [°C]
Verweildauer oberhalb T_L	laut Angabe im Datenblatt [sec]
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Höchsttemperatur T_P	obere Temperaturangabe [°C]
Dauer Höchsttemperatur	laut Angabe im Datenblatt [sec]
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Dauer 25 °C – Höchsttemperatur T_P	max. 8m

Reflow Soldering Recommendation For Shorter Peak Times

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature T_{Smin}	150 °C
Maximum Temperatur T_{Smax}	200 °C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Soldering Range Temperature T_L	Lower Temperature [°C]
Duration above T_L	Acc. to datasheet [sec]
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Peak Temperature T_P	Upper Temperature [°C]
Duration Peak Temperature	Acc. to datasheet [sec]
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Duration 25°C - Peak Temp. T_P	max. 8min

